

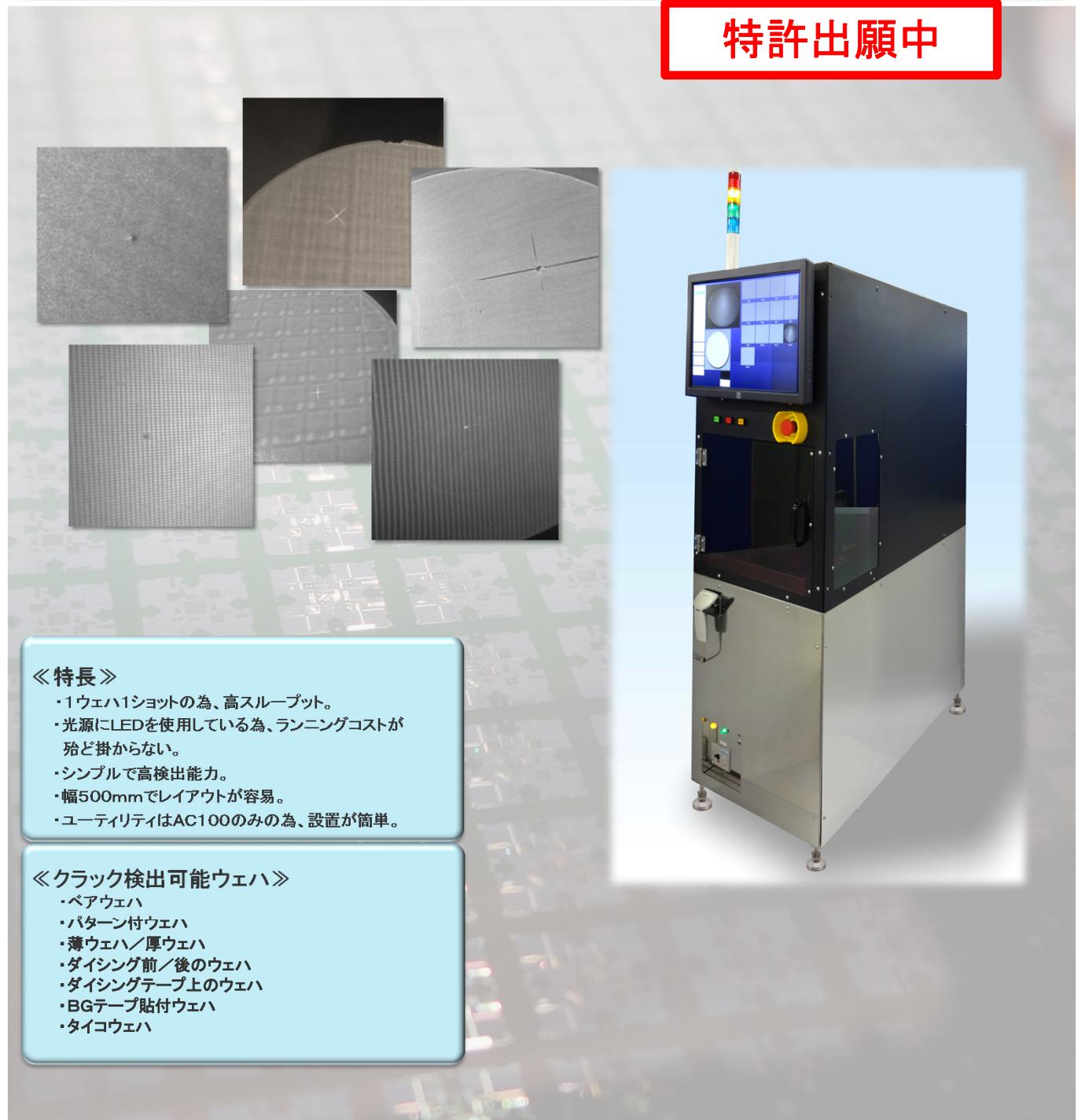
ウェハクラック検査装置

WAFER CRACK INSPECTION SYSTEM

SEL-WCISシリーズ

- ウェハー括撮像・検査(1ショット／1枚)
- 目視では発見が困難な、ウェハの微細クラックを特殊な光学系と画像処理で検出します。
- クラックの入っているウェハを色分け表示。クラックの座標位置をマップ表示。

特許出願中



《特長》

- ・1ウェハ1ショットの為、高スループット。
- ・光源にLEDを使用している為、ランニングコストが殆ど掛からない。
- ・シンプルで高検出能力。
- ・幅500mmでレイアウトが容易。
- ・ユーティリティはAC100のみの為、設置が簡単。

《クラック検出可能ウェハ》

- ・ベースウェハ
- ・パターン付ウェハ
- ・薄ウェハ／厚ウェハ
- ・ダイシング前／後のウェハ
- ・ダイシングテープ上のウェハ
- ・BGテープ貼付ウェハ
- ・タイコウェハ

SPEC SHEET

	WCIS-100 4inch	WCIS-150 6inch	WCIS-200 8inch	WCIS-300 12inch		
検査対象ウェハ	• Si, 化合物半導体であれば、ウェハの種類は問いません。 (両面にフィルムが貼ってあるウェハは検査不可能) (著しく反ったウェハや鏡面で無いウェハは検出不可能) ※1					
検査内容	クラックの検出・表示					
表示方法	• クラックを検出したウェハの番号を表示。 • クラックを検出した場合、そのウェハの画像を自動保存 • クラック位置座標をマップと座標位置で表示。					
スループット	15秒以内／1枚 ※2 (カセットよりウェハ引出し ⇒ 検査 ⇒ 収納まで)			別途お打合せ		
照明	LED					
GUI	タッチパネル					
搬送系	カセット：上下動エレベータ 検査ステージ：一軸			別途お打合せ		
装置サイズ	W : 500 X D : 1100 X H : 1800			別途お打合せ		
電力	AC100V VA:2K(MAX)			別途お打合せ		
重量	約400kg		約450kg	別途お打合せ		
※1 その他のサイズのウェハ、サイズ違いの兼用、ダイシングリング付ウェハは別途ご相談ください。						
※2 もっと高速なスループットをご希望の場合は別途ご相談ください。						

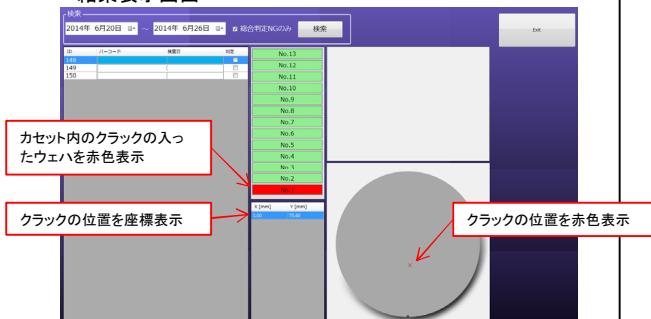
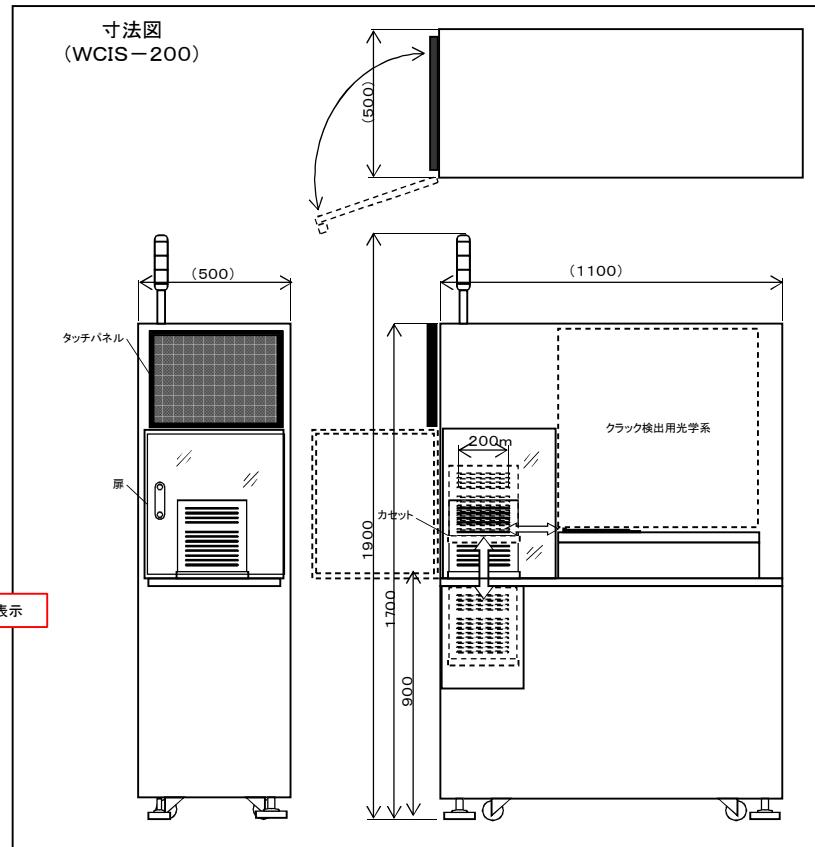
オプション

マップ情報との照合	どのチップにクラックが入っているか、マップ上に表示します。 (お客様のウェハのマップデータが必要となります)
上位通信 FFU	工場側の上位PCとの通信機能(SECS, GEM300など)

検査画面



結果表示画面

寸法図
(WCIS-200)

株式会社 昭和電気研究所

<http://www.showalabo.co.jp>

info@showalabo.co.jp

〒819-0015 福岡市西区愛宕1丁目14-35

PHONE : 092-881-0238 FAX : 092-881-0217